

「ポスト5 G情報通信システム基盤強化研究開発事業／先端半導体製造技術の開発」

実施予定先一覧

No.	開発テーマ	実施予定先
1	(d) 国際連携による次世代半導体製造技術開発 (d2) 光電融合に係る実装技術および確定遅延コンピューティング基盤技術開発 (d2-1) 光チップレット実装技術（委託）	日本電信電話株式会社 NTTイノベティブデバイス株式会社 NTTデバイスクロステクノロジ株式会社 古河電気工業株式会社 新光電気工業株式会社
2	(d) 国際連携による次世代半導体製造技術開発 (d2) 光電融合に係る実装技術および確定遅延コンピューティング基盤技術開発 (d2-2) 光電融合インターフェイスメモリモジュール技術（委託）	キオクシア株式会社 日本電信電話株式会社
3	(d) 国際連携による次世代半導体製造技術開発 (d2) 光電融合に係る実装技術および確定遅延コンピューティング基盤技術開発 (d2-3) 確定遅延コンピューティング基盤技術（助成）	日本電信電話株式会社 日本電気株式会社 富士通株式会社
4	(d) 国際連携による次世代半導体製造技術開発 (d3) Beyond 2nm世代向け半導体技術開発（委託）	技術研究組合最先端半導体技術センター
5	(f) 次世代半導体設計技術開発 (f1) 2nm 世代半導体チップ設計技術開発（委託）	技術研究組合最先端半導体技術センター

以上